**事業含銅廢水排放管理意見調查**

**(個別廠調查)**

環境部自106年起即對高科技和金屬相關產業、科學工業園區和工業區等排放之含銅廢水進行管制，包含晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、化工業、印刷電路板製造業、金屬基本工業、電鍍業和金屬表面處理業等7類行業，以及科學工業園區、石油化學園區及其他工業區等3類專用污水下水道系統，現擬針對管制對象再次加嚴限值，規劃於「放流水標準」中**附表一、二、四、五、九、十及十一加嚴****放流水含銅限值至1.0 mg/L(116年1月1日起)，並對7類行業中放流水量較小者(半導體業、光電業、化工業、印刷電路板業≦500CMD；電鍍業、金表業、金屬基本工業≦150 CMD)加嚴放流水含銅限值至1.5mg/L(116年1月1日起)**。

為了解產業排放實測資料及處理現況，爭取合理產業權益，爰擬收集以下資訊，**敬請業者於113年7月8日前惠復所屬公協會以下資訊：**

1. **所屬公協會：**

**□台灣區表面處理工業同業公會**

**□台灣電路板協會**

**□台灣鋼鐵工業同業公會**

**□台灣區石油化學工業同業公會**

**□台灣區金屬品冶製工業同業公會**

**□台灣區螺絲工業同業公會**

**□台灣半導體產業協會**

**□台灣顯示器暨應用產業協會**

**□台灣光電暨化合物半導體產業協會**

**□太陽光電產業協會**

**□台灣科學園區科學工業同業公會**

**□台灣區電機電子工業同業公會**

1. **工廠名稱及聯絡人：**

|  |  |
| --- | --- |
| 工廠名稱 |  |
| 聯絡人 |  |
| 聯絡電話 |  |
| E-mail |  |

1. **廢水含銅濃度範圍現況：**

 原水進流測值範圍： ~ (mg/L)

 廢水放流測值範圍： ~ (mg/L)

1. **為因應法規加嚴，評估採行措施：(如管末加藥、新增處理設備、分流委託處理高濃度廢液等)**
2. **採行上述措施衍生之其他環境衝擊：(如新增大量污泥、不利放流水回收等，您可自行舉例)**
3. **以整體環境友善為考量，建議調整期程及濃度標準：**
4. **建議實施期程與濃度標準**

|  |
| --- |
| **您建議實施期程與濃度標準** |
| **對象** | **建議實施年份(民國)** | **建議總磷之濃度標準(mg/L)** |
| **現行限值為1.5 mg/L者** | **請填民國年份** | **請填建議濃度** |
| **現行限值為3.0 mg/L者****(半導體業、光電業、化工業、印刷電路板業≦500CMD；電鍍業、金表業、金屬基本工業≦150 CMD)** | **請填民國年份** | **請填建議濃度** |

1. **理由：**
2. **其他方案建議(僅訂定第1階段)。**
3. **其他建議：(如目前無經濟可行技術，嚴重衝擊，建議不訂說明理由)**